

## 臻鼎打造「半導體+先進封裝+PCB」新板圖 「One ZDT」策略迎戰異質整合浪潮 搶占AI產業制高點

印刷電路板產業年度盛會 TPCA Show 2025 今（22）日於南港展覽館熱烈登場，臻鼎科技控股股份有限公司（股票代號：4958）以 AI 為主軸，展出一系列高階 PCB 與高階 IC 載板技術。董事長沈慶芳指出，過去 20 年間，IC 載板的尺寸放大 20 倍、層數增加逾 4 倍、接點數量暴增 300 倍，整體複雜度提升超過 24,000 倍，象徵 PCB 已從連接元件躍升為 AI 運算效能的關鍵核心。面對這波由 AI 與高速運算驅動的產業革命，臻鼎深化「One ZDT」策略佈局，開創「半導體+先進封裝+PCB」的新格局，為未來營運注入成長動能。

沈慶芳表示，AI 時代的競爭不再是單打獨鬥，而是生態系的競爭。先進封裝帶來的不僅是晶片效能的突破，更重塑了半導體與 PCB 產業鏈的合作模式。隨著 AI 高速運算產品設計日益複雜，晶片、封裝與載板三者的關係愈發緊密，從封裝架構、互連方式到散熱策略，都必須在設計初期共同定義，以確保系統效能、散熱與良率的最佳化，這正是臻鼎所強調的「頂層設計」思維。

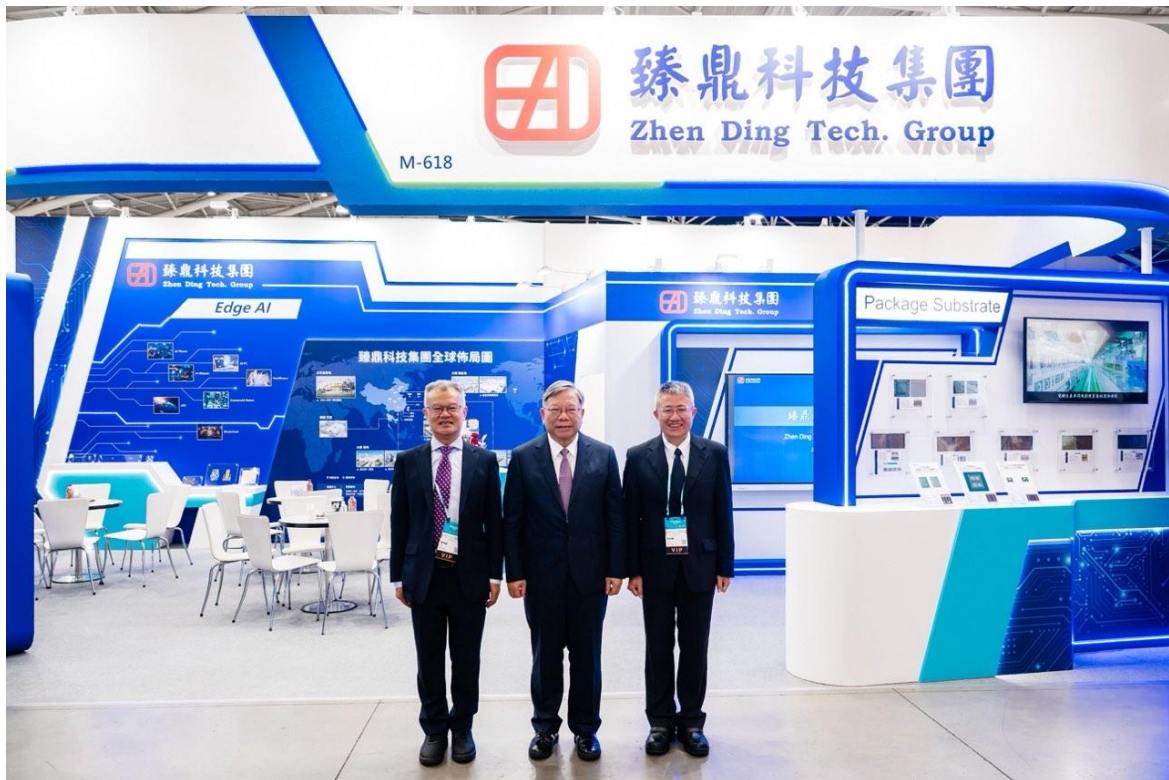
為因應 AI 應用帶動高階 PCB 與高階載板的需求激增，臻鼎持續加碼投資擴充產能，並同步推進 ABF 載板、HDI+HLC、SLP 等高階產品線研發。隨著 AI 市場快速成長，相關營收占比已從去年的 45% 提升至今年的 70% 以上。透過「One ZDT」策略的跨域整合，臻鼎串聯上下游夥伴，建立早期開發協同機制，以實際行動落實 AI 與製程的深度結合，鞏固在 AI 與先進封裝浪潮中的關鍵地位。

臻鼎營運長李定轉於「TPCA Show X 商周 領袖高峰會」論壇時也提到，隨著半導體加速走向異質整合與先進封裝，PCB 不再只是電路的連接載體，更是支撐高效能運算的**智能底座**，如同半導體的航空母艦，PCB 擔任著晶片間高速互連與穩定效能的重任，因此在先進封裝架構下，PCB 需具備更細線寬線距、更低訊號損耗與更優異的熱管理能力，甚至更加強調跨製程的整合，才能讓整體系統效能發揮極致，臻鼎也將持續深化跨域協同與技術整合，推動半導體、封裝與 PCB 的緊密連結，開創 AI 時代的新競爭格局。

展望未來，臻鼎將持續以「One ZDT」策略為核心，深化半導體、先進封裝與 PCB 的垂直整合，同時積極推進智慧製造與數位轉型，導入 AI 於研發與生產流程中，提升製程精度與生產效率。沈慶芳強調，臻鼎面對 AI 浪潮，不僅順應變革，更引領產業升級，透過與全球上下游夥伴的緊密合作與技術共創，臻鼎正以實際行動推動 PCB 產業鏈價值升級，從連接走向承載，從單一設計跨入製程整合，成為驅動異質整合與先進封裝發展的關鍵力量。

### 關於臻鼎科技控股

臻鼎科技控股股份有限公司(台灣證券交易所股票代號: 4958)主要從事研發、生產及銷售多樣化之軟性電路板與模組、類載板、高密度連接板、高多層及高密度印刷電路板(HLC-HDI)、多層硬板、IC 載板等產品，廣泛應用於電腦資訊、消費性電子產品、通訊網路、車用電子、AI 伺服器高速運算、光模塊與醫療等領域，提供客戶一站式購足全方位解決方案的專業服務公司。根據 Prismark 以營收計算的全球 PCB 企業排名，臻鼎 2017 年至 2024 年連續八年榮登全球最大 PCB 生產企業，更多詳細資訊請至公司網站: [www.zdtco.com](http://www.zdtco.com)。



▲ TPCA Show 2025 盛大展開，臻鼎科技集團核心人物齊聚現場，圖左起為總經理簡禎富、董事長沈慶芳、營運長李定轉。



▲ 臻鼎科技集團董事長沈慶芳參與 TPCA Show 2025 開幕剪綵儀式。

公司發言人:

凌 惇

公司治理暨投資人關係處

電話: 886 3 3830101

Email: [duen.t.ling@zdtco.com](mailto:duen.t.ling@zdtco.com)